

1

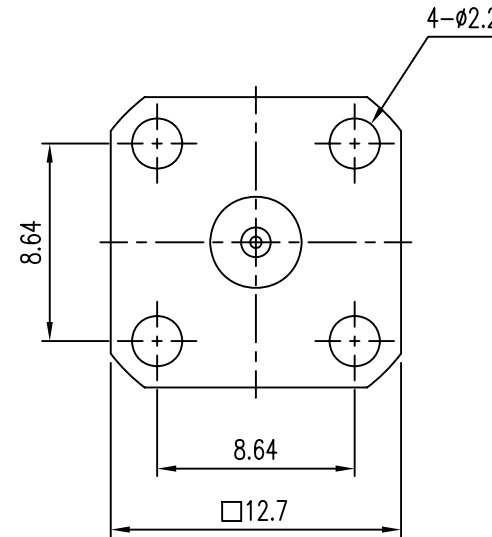
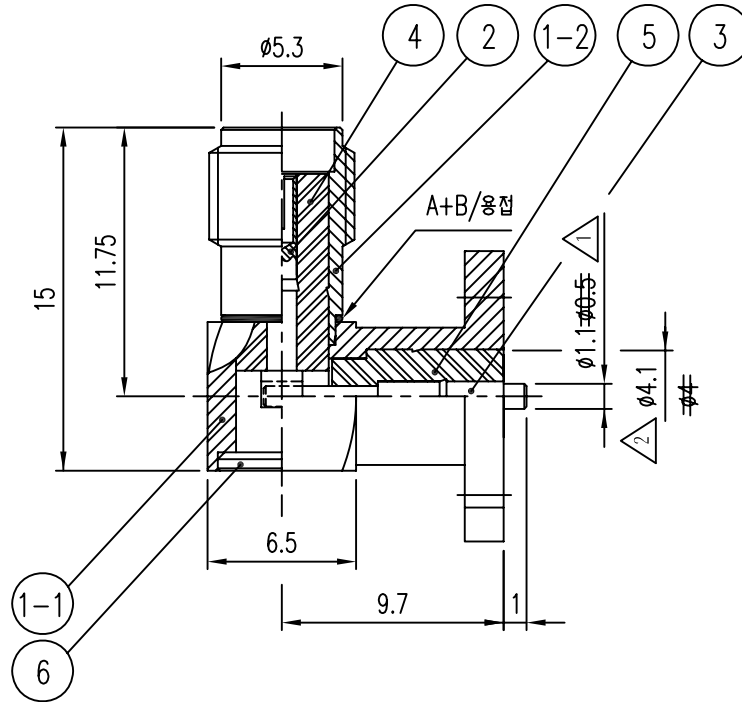
2

3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	설번처리No.200904-0005 PCB와 파 간격이 커서 납땜시 SHORT 발생 개선	김인철	윤상진	2009. 04. 20.
2	설번처리No.202104-0003 배디 PUNCH => HOOK 변경 및 A+B/용접 구조 적용	은선영	김인철	2021. 04. 09.



6	COVER	1	BsS	Gold Plate	DCO00038-5/1 (L2036)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00241-N/2 DIN00241-N/1 (H2262)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01959-5/1 DCT00111-5/1 (E2383)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)
1-2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02134-1/3 DBD00167-5/3 DBD00213-1/1
1-1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00229-1/3 DBD00167-5/4 DBD00229-3/4

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2009. 4. 20.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	검도			도명	SMA-LJ-H4-R	
	재도					
열처리	작성부서			A4	도번	CN01342-7/3
	연 구 소					
보호파막처리	적도 3/1	단위 mm	중량			

1

2

3

4